



そこで、注入範囲を決定するために、まず沢下原因(1)に打ちす対策として図-1の如く掘さく底面より $60^\circ$ と $60^\circ$ のスベリ面を仮定した。土質工にかかす土圧分布は、放物線形で、直線形のスベリ面に比してスベリ面の地表面に切す英は短く、また、地盤を考へてもこのスベリ面の仮定は要座側である。図-1の④は垂直注入である。 $60^\circ$ のスベリ面を目標にして注入深さを決定した。これは、掘さく前に注入し、地盤の内部摩擦角を増大してせり断壊坑を増加するとともに、透水係数を減少させて止水性を高めるため(沢下原因(2)の対策)である。薬液は主として水ガラス系を使用し、試験注入の結果、十分その効果は期待できると思われるが、特に基礎の浅い建物の接近する場合は、適宜高分子系薬液を使用した。⑤は水平注入である。 $60^\circ$ のスベリ面を目標にし、建物の基礎砂利部に注入して、基礎地盤の強化をはかるとともに、地下水位低下に伴う荷重増加に打ちこも建物の安定をはかった(沢下原因(2)の対策)。注入液は主としてセメントフライッシュを使用したが、間隙の粗い層(基礎砂利部、建物建設時に孔した箇所)への注入は可能であり、地耐力増強には有効である。⑥は斜注入である。 $60^\circ$ のスベリ面を目標にしたが、水平注入の困難な建物あるいは高層建物の接近する場所等④⑤の補足注入として掘さく前に注入した。以上④⑤⑥の注入により沢下原因(3)に打ちす対策として十分である。なお、垂直注入の注入延長は、建物前面と、両側掘さく深さの $\frac{1}{2}$ 程度の区間で、注入中は浮き注入対象範囲とした。

## 2-2 注入工

注入は、所定深さまで土く孔後、孔底より1スラップ1mのスラップ注入を行った。また、セメントを除く他の薬液は、2液1工程方式で注入し、注入量は、セメントは注入対象地盤の20%、水ガラス系、高分子系は25%と決めて施工したが、施工実績は、セメント19%、水ガラス系26%、高分子系27%であった。注入施工順序は図-1の如く、まず、仮造柱の小エリセメント注入を行って、粗い間隙を噴きした後、水ガラス系、高分子系の薬液を手島状に注入した。注入圧力は3%までを目標にしたが、たまには5%をこえる場合もあったので、このときは、所要注入量が入らずとも次のスラップに移った。また、付ルリウムは、砂層で1~5分、シルト層で5~10分程度である。

## 3 沿道建物の沢下程度

工事着手前に建物の事前調査を行い、現状を確認し、工事工程の進捗とともに、工程に合わせて、定期的に建物の沢下、傾斜測定を実施した。その結果、図-2の如く、6号線の沿道建物の最終沢下量は2~3mm以内におさまり、このことは、3年前後の建設工事期間であることを考へるとほとんどの問題なく施工できたと考えられる。

なお、図-2のDビルについては、地下鉄工事埋込し時に、隣接してビル新築工事(掘さく約10')が始まり、その影響で沢下量が増進していきこれを示している。

また、建物の傾斜測定については、ほとんどの測定誤差程度であった。

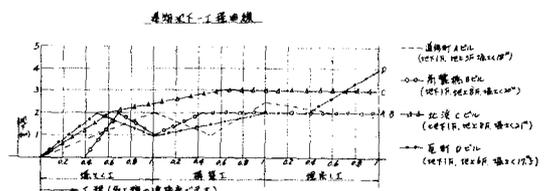


図-2